



2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年10月31日

上場会社名 株式会社たけびし 上場取引所 東
コード番号 7510 URL <https://www.takebishi.co.jp>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 岡垣 浩志
問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員 (氏名) 大井 武 TEL 075-325-2118
経営戦略室長
四半期報告書提出予定日 2023年11月10日 配当支払開始予定日 2023年12月4日
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無：有

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第2四半期の連結業績（2023年4月1日～2023年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第2四半期	50,338	8.0	1,969	4.3	2,180	8.7	1,416	5.7
2023年3月期第2四半期	46,617	26.3	1,889	26.8	2,006	26.5	1,340	26.9

(注) 包括利益 2024年3月期第2四半期 2,634百万円 (21.6%) 2023年3月期第2四半期 2,167百万円 (75.6%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第2四半期	88.73	—
2023年3月期第2四半期	84.00	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年3月期第2四半期	66,718	37,824	56.7
2023年3月期	64,076	35,608	55.6

(参考) 自己資本 2024年3月期第2四半期 37,806百万円 2023年3月期 35,595百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期	—	27.00	—	29.00	56.00
2024年3月期	—	29.00	—	—	—
2024年3月期(予想)	—	—	—	29.00	58.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2024年3月期の連結業績予想（2023年4月1日～2024年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	100,000	2.7	3,980	1.6	4,150	2.7	2,770	1.2	173.56

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2024年3月期2Q	15,986,000株	2023年3月期	15,961,000株
② 期末自己株式数	2024年3月期2Q	976株	2023年3月期	945株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年3月期2Q	15,967,194株	2023年3月期2Q	15,960,059株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づいております。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7
3. その他	8
(1) 連結の販売状況	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、半導体・電子部品の供給不足緩和により、自動車や機械等の生産で持ち直しの動きが見られたものの、欧米の金融引締めや中国不動産の過剰債務問題を背景に、世界的な景気後退懸念が強まる等、先行きの不透明な状況で推移しました。

このような状況下、当社グループは2026年度連結売上高1,300億円、NEWビジネス プラス300億円、連結経常利益60億円、ROE 9%を目標とする新中期ビジョン『T-L i n k 1 3 6 9』を始動し、FA機器等の基幹ビジネスの更なる拡大に加え、「グローバル」「メディカル」「オートメーション」「オリジナル」の4つの成長戦略の更なる進化や、総合商社を目指した「エネルギーソリューション」「モビリティ」「マテリアル」等のビジネス領域拡大にも注力し、成長市場に適応した「NEWビジネスの創造」に取り組んでまいりました。

更には、当社オリジナル製品やシステム提案等、当社の強みである技術力を活かした独自のソリューションによる付加価値の高いビジネスモデルの構築にも注力してまいりました。

これらの結果、当第2四半期連結累計期間における業績は、売上高503億38百万円（前年同期比8.0%増）、営業利益19億69百万円（前年同期比4.3%増）、経常利益21億80百万円（前年同期比8.7%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益14億16百万円（前年同期比5.7%増）となりました。

<セグメント別の状況>

産業機器システム分野においては、産業メカトロニクスが前年にあった産業用加工機の大口案件の影響により減少したことに加え、装置システムが液晶向け等で減少したものの、FA機器が半導体製造装置関連やEV用電池関連向けを中心に増加したことから、この部門全体の売上高は前年同期比1.7%の増となりました。

半導体・デバイス分野においては、デバイスが在庫調整局面を背景とした需要減少により、中国やマレーシア等を中心に低調に推移したものの、インドの車載関連向けが増加したことに加え、国内で半導体製造装置やセキュリティ関連向けが堅調に推移したことから、この部門全体の売上高は前年同期比1.9%の増となりました。

これらの結果、FA・デバイス事業においては、売上高377億36百万円（前年同期比1.8%増、構成比75.0%）、営業利益は人件費等の販売管理費が増加したことにより、16億38百万円（前年同期比1.3%減）となりました。

社会インフラ分野においては、昇降機を中心としたビル設備や、放射線がん治療装置及び医療用診断装置が増加したことから、この部門全体の売上高は前年同期比43.5%の増となりました。

情報通信分野では、OA機器が堅調に推移したことに加え、主力の携帯電話では高価格端末の販売増や5G基地局設計以外のアスベスト調査等新たなビジネスが増加したことから、この部門全体の売上高は前年同期比9.9%の増となりました。

これらの結果、社会・情報通信事業においては、売上高126億2百万円（前年同期比32.0%増、構成比25.0%）、営業利益は3億31百万円（前年同期比43.9%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ26億42百万円増加し、667億18百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加17億28百万円と、売上債権の増加11億37百万円があったことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末より4億27百万円増加し、288億94百万円となりました。これは主に、短期借入金金の減少9億0百万円があったものの、仕入債務の増加15億12百万円があったことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末より22億15百万円増加し、378億24百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加9億53百万円と為替換算調整勘定の増加6億87百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年3月期の通期連結業績予想につきましては、2023年4月28日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,494	8,223
受取手形、売掛金及び契約資産	21,901	22,957
電子記録債権	6,669	6,751
商品	13,591	13,278
仕掛品	44	141
その他	2,235	1,949
貸倒引当金	△104	△77
流動資産合計	50,832	53,225
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,912	1,965
土地	2,105	2,105
建設仮勘定	129	107
その他（純額）	139	147
有形固定資産合計	4,286	4,326
無形固定資産		
ソフトウェア	81	75
のれん	1,076	927
顧客関連資産	936	848
その他	20	20
無形固定資産合計	2,114	1,870
投資その他の資産		
投資有価証券	5,399	6,171
繰延税金資産	210	182
その他	1,242	949
貸倒引当金	△9	△6
投資その他の資産合計	6,843	7,296
固定資産合計	13,243	13,493
資産合計	64,076	66,718

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	16,787	17,139
電子記録債務	1,508	2,669
短期借入金	4,837	3,937
1年内返済予定の長期借入金	—	100
未払金	1,237	870
未払法人税等	926	871
賞与引当金	843	805
役員賞与引当金	—	107
その他	711	831
流動負債合計	26,853	27,332
固定負債		
長期借入金	250	—
長期未払金	49	49
繰延税金負債	959	1,167
再評価に係る繰延税金負債	5	5
役員退職慰労引当金	40	33
退職給付に係る負債	235	229
資産除去債務	26	27
その他	46	48
固定負債合計	1,613	1,562
負債合計	28,467	28,894
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,384	3,406
資本剰余金	4,058	4,080
利益剰余金	25,625	26,579
自己株式	△0	△0
株主資本合計	33,069	34,066
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,382	2,915
土地再評価差額金	△1,140	△1,140
為替換算調整勘定	1,198	1,885
退職給付に係る調整累計額	85	79
その他の包括利益累計額合計	2,526	3,740
非支配株主持分	13	17
純資産合計	35,608	37,824
負債純資産合計	64,076	66,718

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
売上高	46,617	50,338
売上原価	39,922	43,248
売上総利益	6,695	7,090
販売費及び一般管理費	4,805	5,120
営業利益	1,889	1,969
営業外収益		
受取利息	3	4
受取配当金	62	78
仕入割引	7	7
受取賃貸料	27	26
保険解約返戻金	—	88
その他	51	69
営業外収益合計	152	275
営業外費用		
支払利息	14	46
賃貸収入原価	12	13
その他	8	4
営業外費用合計	35	64
経常利益	2,006	2,180
特別利益		
固定資産売却益	—	8
特別利益合計	—	8
特別損失		
固定資産除売却損	6	15
減損損失	—	21
特別損失合計	6	36
税金等調整前四半期純利益	2,000	2,152
法人税、住民税及び事業税	663	723
法人税等調整額	△4	9
法人税等合計	658	732
四半期純利益	1,341	1,420
非支配株主に帰属する四半期純利益	1	3
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,340	1,416

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
四半期純利益	1,341	1,420
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△300	533
為替換算調整勘定	1,135	687
退職給付に係る調整額	△9	△6
その他の包括利益合計	825	1,214
四半期包括利益	2,167	2,634
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,167	2,631
非支配株主に係る四半期包括利益	0	2

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

1. 前第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日 至2022年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位:百万円)

	F A ・ デバイス事業	社会 ・ 情報通信事業	合計
売上高			
外部顧客への売上高	37,072	9,545	46,617
セグメント間の内部売上高又は振替高	0	—	0
計	37,072	9,545	46,617
セグメント利益	1,659	230	1,889

2. 当第2四半期連結累計期間(自2023年4月1日 至2023年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位:百万円)

	F A ・ デバイス事業	社会 ・ 情報通信事業	合計
売上高			
外部顧客への売上高	37,736	12,602	50,338
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	37,736	12,602	50,338
セグメント利益	1,638	331	1,969

3. その他

(1) 連結の販売状況

事業区分	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)			前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
	売上高 (百万円)	構成比 (%)	売上高 (百万円)	構成比 (%)	前年同期比 増減率 (%)	売上高 (百万円)	構成比 (%)
産業機器システム	20,743	44.5	21,103	41.9	1.7	41,898	43.0
半導体・デバイス	16,328	35.0	16,633	33.0	1.9	34,757	35.7
F A ・デバイス事業	37,072	79.5	37,736	75.0	1.8	76,655	78.7
社会インフラ	6,275	13.5	9,008	17.9	43.5	13,701	14.1
情報通信	3,269	7.0	3,593	7.1	9.9	7,047	7.2
社会・情報通信事業	9,545	20.5	12,602	25.0	32.0	20,748	21.3
合計	46,617	100.0	50,338	100.0	8.0	97,404	100.0

(注) 1. 上記金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。